



[A] TIIVISTELMÄ - SAMMANDRAG

(11) (21) Patentihakemus - Patentansökan 20031341

(51) Kv.lk.7 - Int.kl.7

H05K 1/18, 3/32

SUOMI - FINLAND

(FI)

(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag 18.09.2003

(24) Alkupäivä - Löpdag 18.09.2003

(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig 19.03.2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

(71) Hakija - Sökande

1 •Imbera Electronics Oy, PL 74, 02151 Espoo, SUOMI - FINLAND, (FI)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1 •Iihola,Antti, Koskelantie 33 A 5, 00610 Helsinki, SUOMI - FINLAND, (FI)

2 •Jokela,Timo, Luhtimäentie 2b as. 1, 24800 Halikko, SUOMI - FINLAND, (FI)

(74) Asiamies - Ombud: Seppo Laine Oy
Itämerenkatu 3 B, 00180 Helsinki

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Menetelmä elektroniikkamoduulin valmistamiseksi
Förfarande för tillverkning av en elektronikmodul

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Menetelmä elektroniikkamoduulin valmistamiseksi, jossa valmistus aloitetaan eristemateriaalilevystä (1), joka käsittää johdekerroksen. Levyyn (1) valmistetaan ainakin yksi syvennys, joka ulottuu eristemateriaalikerroksen (1) läpi vastakkaisella pinnalla olevaan johdekerrokseen saakka. Syvennykseen asetetaan komponentti (6) kontaktointipinta johdekerrosta kohti ja kiinnitetään komponentti (6) johdekerrokseen. Tämän jälkeen syvennyksen sulkevasta johdekerroksesta muodostetaan johdekuvio (14), joka liittyy sähköisesti ainakin joihinkin syvennykseen asetetun komponentin (6) kontaktialueista tai kontaktinystyistä.

Förfarande för tillverkning av en elektronikmodul, där tillverkningen påbörjas från en isoleringsmaterialskiva (1) omfattande ett ledarskikt. I skivan (1) bildas åtminstone en kavitet, vilken sträcker sig genom isoleringsmaterialskiktet (1) ända till ledarskiktet på den motsatta ytan. I kaviteten anordnas en komponent (6) med kontaktbildningsytan mot ledarskiktet, och komponenten (6) fästs vid ledarskiktet. Härefter bildas ett ledarmönster (14) av det ledarskikt som tillsluter kaviteten, vilket mönster är elektriskt anslutet till åtminstone några av den i kaviteten anordnade komponentens (6) kontaktområden eller kontaktnystor.

